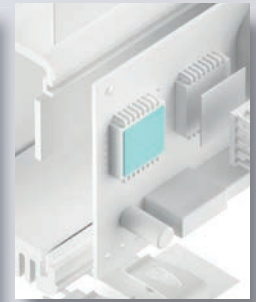


TGR-S-SI ist eine thermisch hoch leitfähige Silikonwärmeleitpaste auf der Basis einer Silikonmatrix. Mit ihr lassen sich sehr gute und hochzuverlässige thermische Anbindungen elektronischer Bauelemente erreichen. Durch die Formulierung und Füllung des Materials mit Keramikpulver ergibt sich eine sehr hohe thermische Leitfähigkeit. Durch ihren Einsatz werden der thermische Kontakt- und Gesamtübergangswiderstand minimiert.



Stand 11 / 2018

EIGENSCHAFTEN

- Wärmeleitfähigkeit: 3,3 W/mK
- Dispensierbar
- Fast drucklose Aufbringung
- Hohe dielektrische Durchschlagsfestigkeit
- Betriebstemperaturbereich: - 40 bis 200°C

LIEFERFORMEN

- Kartusche
- Behälter 0,5 kg / 5 kg
- Auf Anfrage

ANWENDUNGSBEISPIELE

Thermische Anbindung von z.B.

- LED Boards
- Leistungsmodulen
- RDRAM Speicherbausteine
- Flip Chips, DSPs, BGAs, PPGAs
z.B. in Automotiveanwendungen /
Leistungselektronik / Lichttechnik /
Industriecomputer

Eigenschaft	Einheit	TGR-S-SI
Material		Keramik gefüllte Wärmeleitpaste
Farbe		Weiss
Dichte	g / cm ³	3,2
Viskosität @ 25°C	Pas	140
Anteil volatiler Bestandteile (@ 24 h @ 150°C)	%	0,1
Anteil niedrig molekularer Siloxane Σ D ₃ -D ₁₀	ppm	< 100
RoHS Konformität	2011 / 65 / EU	Ja
Thermisch		
Thermische Leitfähigkeit	W/mK	3,3
Betriebstemperaturbereich	°C	- 40 bis + 200
Lagertemperatur	°C	< 40 °C
Lagerzeit	Monate @ RT	12
Elektrisch		
Durchschlagsfestigkeit	kV / mm	12,5

Angaben unverbindlich, technische Änderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Daten und Informationen.

